

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-014

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于对外投资进展暨全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资事项概述

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为落实原有投资规划并优化集成电路玻璃基板及器件的研发、生产和销售项目实施节奏，与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会于2026年2月2日签订了《投资协议书(二)》，具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议书（二）暨对外投资进展的公告》。根据协议，项目实施主体强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通子公司”）需不晚于2026年3月15日完成增加注册资本1.5亿元的工商变更登记手续。

二、对外投资事项进展

近日，南通子公司工商变更手续已完成，并取得了江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

名称：强一半导体（南通）有限公司

统一社会信用代码：91320693MACDTBBN78

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周明

注册资本：35000 万元人民币

成立日期：2023 年 04 月 12 日

住所：南通苏锡通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 5 号楼 8203-496 室（CSSD）

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月3日